



Vorbelastungsgesetz zur nationalen Umsetzung des Chip-Gesetzes und Chip-Gesetz Begleitmaßnahmengesetz

Analyse

Grundlage für die Analyse ist folgendes Dokument:

- ♦ Antrag der Abgeordneten Gabriel Obernosterer, Mag. Dr. Jakob Schwarz, BA, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem die Begründung von Vorbelastungen durch den Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft genehmigt und mit dem das Bundesgesetz hinsichtlich Begleitmaßnahmen zur Durchführung der Verordnung (EU) 2023/1781 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. September 2023 zur Schaffung eines Rahmens für Maßnahmen zur Stärkung des europäischen Halbleiter-Ökosystems und zur Änderung der Verordnung (EU) 2021/694 (Chip-Gesetz-Begleitmaßnahmen-gesetz) erlassen wird (3656/A)



1 Europäisches Chip-Gesetz

Das **europäische Chip-Gesetz** ([Verordnung \(EU\) 2023/1781](#) des Europäischen Parlaments und des Rates) ist am 21. September 2023 in Kraft getreten und beinhaltet ein Maßnahmenpaket zur Versorgungssicherheit, Resilienz und zur technologischen Führungsrolle der Europäischen Union (EU) **im Bereich Halbleitertechnologie und -anwendungen. Die EU hat einen Weltmarktanteil** von nur 10 % bei der Produktion von Mikrochips und ist in hohem Ausmaß von Lieferanten aus Drittländern abhängig. Mit dem Chip-Gesetz will die EU die Produktion von Mikrochips in der EU fördern und dadurch unabhängiger von anderen Märkten wie etwa China werden. Der Weltmarktanteil soll bis 2030 auf 20 % erhöht werden. Dazu sollen sowohl staatliche als auch private Mittel von insgesamt 43 Mrd. EUR mobilisiert werden. Die staatlichen Mittel werden teilweise aus dem EU-Haushalt, teilweise aus Mitteln der Mitgliedstaaten aufgebracht. Das Chip-Gesetz besteht aus drei Säulen, der Initiative „Chips für Europa“, dem Rahmen zur Versorgungssicherheit und dem Notfallmechanismus.

Die 1. Säule im Kapitel II der EU-Verordnung dient der Förderung des Aufbaus groß angelegter technologischer Kapazitäten und Innovationen und soll unter dem Titel Initiative „Chips für Europa“ den Übergang vom Labor zur Fertigung verbessern. Die 1. Säule soll im Rahmen eines gemeinsamen Unternehmens, dem Chips Joint Undertaking, umgesetzt werden.

Die 2. Säule im Kapitel III der EU-Verordnung schafft einen Rahmen zur Verbesserung der Versorgungssicherheit mit Chips in der EU, indem in- und ausländische Investitionen angezogen und der Aufbau neuer Produktionskapazitäten unterstützt werden. Der Rahmen ermöglicht die Gewährung von Beihilfen auf Basis einer Prüfung durch die Europäische Kommission. Die 2. Säule wird aus nationalen Mitteln finanziert und bietet den Mitgliedstaaten die Möglichkeit zur Deckung der Finanzierungslücke neuartiger Produktionsanlagen der Unternehmen.

Die 3. Säule im Kapitel IV der EU-Verordnung dient dem Aufbau eines Mechanismus für die Überwachung und Krisenreaktion entlang der gesamten Lieferkette. Sie beinhaltet einen Überwachungsmechanismus auf Basis von Frühwarnindikatoren und Maßnahmen zur Krisenbekämpfung im Falle einer Krise.



Der gegenständliche selbständige Antrag ([3656/A](#)) schafft die Grundlagen für die nationale Umsetzung von Projekten gemäß den Bestimmungen des Kapitel II des Chip-Gesetzes (Initiative „Chips für Europa“) sowie für Unternehmensinvestitionen unter den Bestimmungen des Kapitel III des europäischen Chip-Gesetzes.

2 Vorbelastungsgesetz zur nationalen Umsetzung des Chip-Gesetzes

Für die Umsetzung der Maßnahmen zum Aufbau von Produktionskapazitäten bedarf es entsprechender Budgetmittel. Damit der Bund die entsprechenden Verpflichtungen eingehen kann, muss mit einem Vorbelastungsgesetz Vorsorge für künftige Finanzjahre getroffen werden. Die bundesgesetzliche Ermächtigung zur Begründung der Vorbelastungen ist notwendig, weil zumindest in einem Jahr die jeweiligen Vorbelastungen 10 % der Auszahlungsobergrenze der UG 40-Wirtschaft im zuletzt veröffentlichten Bundesfinanzrahmengesetz (BFRG) überschreiten. Insgesamt soll der Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft ermächtigt werden, im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen Vorbelastungen iHv bis zu 2,8 Mrd. EUR in den Jahren 2024 bis 2031 zu begründen. Die Verteilung der Beträge auf diesen Zeitraum ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

Tabelle 1: Ermächtigung zu Vorbelastungen aus dem Chip-Gesetz

<i>in Mio. EUR</i>	2024	2025	2026	2027	2028 bis 2031	Gesamt
Vorbelastungen zur nationalen Umsetzung des Chip-Gesetzes	150	100	75	75	2.400	2.800

Quelle: Selbständiger Antrag (3656/A).

Die für die Umsetzung des europäischen Chip-Gesetzes im BVA-E 2024 veranschlagten Budgetmittel betragen insgesamt 160 Mio. EUR. Neben den aus dem Vorbelastungsgesetz ersichtlichen 150 Mio. EUR in der UG 40-Wirtschaft werden noch 10 Mio. EUR in der UG 34-Innovation und Technologie (Forschung) veranschlagt.



3 Chip-Gesetz Begleitmaßnahmengesetz

Mit der Abwicklung des Förderprogramms betreffend Vorhaben gemäß Kapitel III des europäischen Chip-Gesetzes wird die Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mit beschränkter Haftung (aws) im Namen und auf Rechnung des Bundes beauftragt. Der aws sind dazu bis 2031 maximal 2,8 Mrd. EUR zur Verfügung zu stellen. Die Gewährung von Förderungen nach den Bestimmungen des Kapitel III (2. Säule) erfolgt auf Basis von Richtlinien, die der Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen und der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie erlässt. Gefördert werden neuartige Anlagen im Halbleitersektor, die gemäß der EU-Verordnung als Integrierte Produktionsstätte bzw. als offener EU-Fertigungsbetrieb gelten. Die Förderungsrichtlinien müssen von der EK genehmigt werden.

Zur Erhebung des Potenzials sowie des Budgetbedarfs der österreichischen Halbleiterbranche in Bezug auf Projekte im Rahmen der 2. Säule des europäischen Chips Act erfolgte bereits ein [Aufruf zur Interessensbekundung](#). Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass nur eine begrenzte Anzahl von Unternehmen für die entsprechenden Förderungsmaßnahmen in Betracht kommt.

Das Chip-Gesetz Begleitmaßnahmengesetz regelt auch die nationale Zuständigkeit für die Abwicklung der Förderungen nach Kapitel II (1. Säule) des europäischen Chip-Gesetzes mit der die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie betraut wird. Die diesbezüglichen Richtlinien sind reziprok von ihr im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen sowie dem Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft zu erlassen.



Abkürzungsverzeichnis

aws	Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mit beschränkter Haftung
BFRG	Bundesfinanzrahmengesetz
EK	Europäische Kommission
EU	Europäische Union
EUR	Euro
iHv	in Höhe von
Mio.	Million(en)
Mrd.	Milliarde(n)
UG	Untergliederung(en)